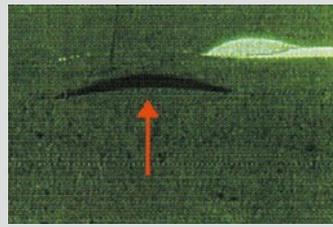


【原因、判断要点、发生工序】层压板铜箔的下面夹杂杂物,或者基材树脂有缺陷等所引起的(层压工序、板件制造工序、可靠性试验)

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by the presence of a foreign material under copper foil or a defect in the laminate resin of the base material (CCL manufacturing, PWB fabrication and reliability testing)



【コメント】
樹脂中の剥離
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
樹脂的剥离
显微镜倍率 ×

【Comments】
Delamination in
laminate resin
Magnification: ×

回路欠陥

SR欠陥

シンボルマーク欠陥

めっき欠陥

スルーホール欠陥

機械加工欠陥

その他欠陥

信頼性不足

はんだ上がり欠陥

電子部品のはんだ周り欠陥

7-4 その他(その他欠陥)/其它(其它的缺陷)/Others(other defects)

7-4-1 カーボン印刷異物巻き込み/碳油卷入杂物/ Foreign object in carbon paste print

【特徴】カーボン印刷インク部に異物が付着または巻き込まれている状態の欠陥

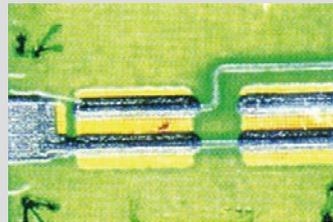
【特征】碳油附着或者卷入杂物的缺陷。

【Characteristics】A foreign object is adhered to or entrapped in the carbon paste printed area.

【原因・判断ポイント・発生工程】カーボン印刷乾燥前の段階で、何らかの異物が付着または巻き込まれて出来たもの(カーボン印刷工程)

【原因、判断要点、发生工序】在碳油烘干前,附着或者卷入某种杂物所引起的(碳油印刷工序)。

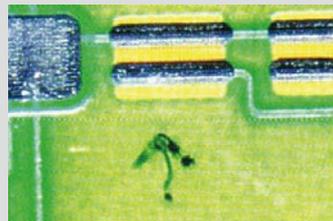
【Causes/processes involved/keys to judgment】
A foreign object is adhered or entrapped in the carbon-paste printed board before paste curing. (Carbon paste printing process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

7-4-2 チェッカ打痕/通断的压痕/ Dent by test probe

【特徴】回路端子部に、電気導通検査用プローブ痕や傷が付いている状態の欠陥

【特征】在插脚有通断测试针痕迹、或者压伤痕迹的缺陷。